

PLATEFORME DE MICRO ET NANOTECHNOLOGIES

CANEVAS DE TRAVAUX

NOM DU PROJET : NITRIDE	REFERENCE COMTEAM OU RENATECH : NBS-02-14
Nom du rédacteur : BERNARD LEGRAND	Signature :
Nom du permanent porteur du projet : BERNARD LEGRAND	Signature :
Nom du coordinateur TEAM : ADRIAN LABORDE	Signature :
Date de la validation : <small>Cliquez ici pour entrer une date.</small>	Référence de la fiche de processus associée : <small>Cliquez ici pour taper du texte.</small>
POUR CHAQUE OPERATION DETERMINER LA SEQUENCE ET LE LIEU DE STOCKAGE (menus déroulants)	
OPERATION 1	SEQUENCE : -
STOCKAGE : -	
Libellé : Implantation ionique pleine plaque pour contact ohmique + recuit	
Verrou technologique éventuel : Cliquez ici pour taper du texte.	
OPERATION 2	SEQUENCE : -
STOCKAGE : -	
Libellé : Lithographie niveau 0 : tranchées	
Verrou technologique éventuel : Cliquez ici pour taper du texte.	
OPERATION 3	SEQUENCE : -
STOCKAGE : -	
Libellé : Gravure RIE silicium 350 nm jusqu'au BOX	
Verrou technologique éventuel : Cliquez ici pour taper du texte.	
OPERATION 4	SEQUENCE : -
STOCKAGE : -	
Libellé : Dépôt nitrure LPCVD 15 nm + oxyde de protection 100 nm (LPCVD ?)	
Verrou technologique éventuel : Qualité diélectrique du nitrure de 10 nm	
OPERATION 5	SEQUENCE : -
STOCKAGE : -	
Libellé : Lithographie niveau 1 : contacts ohmiques	

Verrou technologique éventuel : Cliquez ici pour taper du texte.		
OPERATION 6	SEQUENCE : -	STOCKAGE : -
Libellé : Métallisation Ti/Au contacts ohmiques, lift off et recuit		
Verrou technologique éventuel : Cliquez ici pour taper du texte.		
OPERATION 7	SEQUENCE : -	STOCKAGE : -
Libellé : désoxydation 100 nm BHF, arrêt sur la couche de nitrure		
Verrou technologique éventuel : Cliquez ici pour taper du texte.		
OPERATION 8	SEQUENCE : -	STOCKAGE : -
Libellé : Dépôt chrome pulvérisation cathodique 20 nm		
Verrou technologique éventuel : Dépôt conforme dans les tranchées. Contraintes résiduelles ?		
OPERATION 9	SEQUENCE : -	STOCKAGE : -
Libellé : Lithographie niveau 2 : définition zone active		
Verrou technologique éventuel : Cliquez ici pour taper du texte.		
OPERATION 10	SEQUENCE : -	STOCKAGE : -
Libellé : Gravure chimique chrome 20 nm + gravure RIE 15 nm nitrure		
Verrou technologique éventuel : Cliquez ici pour taper du texte.		
OPERATION 11	SEQUENCE : -	STOCKAGE : -
Libellé : Lithographie niveau 3 : définition du niveau structurel		
Verrou technologique éventuel : Cliquez ici pour taper du texte.		
OPERATION 12	SEQUENCE : -	STOCKAGE : -
Libellé : Gravure structurelle : RIE silicium 350 nm, arrêt sur BOX		
Verrou technologique éventuel : Cliquez ici pour taper du texte.		
OPERATION 13	SEQUENCE : -	STOCKAGE : -
Libellé : Lithographie niveau 4 : ouvertures pour épaissement des contacts		

Verrou technologique éventuel : Cliquez ici pour taper du texte.		
OPERATION 14	SEQUENCE : -	STOCKAGE : -
Libellé : Dépôt d'or de 200 nm en pulvérisation cathodique et lift-off		
Verrou technologique éventuel : Dépôt conforme (au niveau des tranchées)		
OPERATION 15	SEQUENCE : -	STOCKAGE : -
Libellé : Lithographie niveau 5 : protection pour releasing (optionnel)		
Verrou technologique éventuel : Cliquez ici pour taper du texte.		
OPERATION 16	SEQUENCE : -	STOCKAGE : -
Libellé : Releasing humide BHF, contrôlé en temps, rinçage méthanol, séchage plaque		
Verrou technologique éventuel : Cliquez ici pour taper du texte.		
OPERATION 17	SEQUENCE : -	STOCKAGE : -
Libellé : Cliquez ici pour taper du texte.		
Verrou technologique éventuel : Cliquez ici pour taper du texte.		
OPERATION 18	SEQUENCE : -	STOCKAGE : -
Libellé : Cliquez ici pour taper du texte.		
Verrou technologique éventuel : Cliquez ici pour taper du texte.		
OPERATION 19	SEQUENCE : -	STOCKAGE : -
Libellé : Cliquez ici pour taper du texte.		
Verrou technologique éventuel : Cliquez ici pour taper du texte.		
OPERATION 20	SEQUENCE : -	STOCKAGE : -
Libellé : Cliquez ici pour taper du texte.		
Verrou technologique éventuel : Cliquez ici pour taper du texte.		